

目录

留意期刊:	2
THE VISUAL COMPUTER(TVC)	2
IEEE SENSORS JOURNAL(IEEE trans)	2
IEEE Access(名声很臭，但是好投)	3
IEEE Transactions on Industrial Informatics(双一区, top)	3
IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS	4
ICME ICASSP	4
期刊会议相关	4
期刊层次查询网站	4
文献来源	5
综述_Deep Learning for 3D Point Clouds: A Survey	5
综述_Deep 3D Object Detection Networks Using LiDAR Data A Review	6
综述_A Survey on 3D Object Detection Methods for Autonomous Driving Applications	6
综述_作为一个 0 基础三维点云深度学习的研究生，如何快速入 门？ - 知乎 (zhihu.com)	6

留意期刊：

THE VISUAL COMPUTER(TVC)

大类 3 区 | 小类 3 区 | CCF-C | 2022 年影响因子：3.5

<https://www.x-mol.com/8Paper/1201710392250535936>

审稿周期还可以，5 个月左右

VISUAL COMPUTER			
刊名	VISUAL COMPUTER		
年份	2021		
ISSN	0178-2789		
Review	否		
Open Access	否		
Web of Science	SCIE		
	学科	分区	Top期刊
大类	计算机科学	3	否
小类	COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机: 软件工程	3	-

IEEE SENSORS JOURNAL(IEEE trans)

IEEE SENSORS JOURNAL | 审稿快，但第一次大修重投是基本操作 | 名声不错，但是跟计算机方向不太吻合

2021年			
IEEE SENSORS JOURNAL			
刊名	IEEE SENSORS JOURNAL		
年份	2021		
ISSN	1530-437X		
Review	否		
Open Access	否		
Web of Science	SCIE		
	学科	分区	Top期刊
大类	工程技术	2	否
小类	INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 仪器仪表	2	-
	PHYSICS, APPLIED 物理: 应用	2	
	ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程: 电子与电气	3	

IEEE Access(名声很臭，但是好投)

2021年			
IEEE Access			
刊名	IEEE Access		
年份	2021		
ISSN	2169-3536		
Review	否		
Open Access	是		
Web of Science	SCIE		
	学科	分区	Top期刊
大类	计算机科学	3	否
小类	ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程：电子与电气	3	-
	TELECOMMUNICATIONS 电信学	3	
	COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机：信息系统	4	

IEEE Transactions on Industrial Informatics(双一区, top)

分区很高，并且风评不错，所以难是肯定的。

但是，学科比较杂，定位不清楚，相较于计算机领域的 top 期刊，这个可能好一些。

IEEE Transactions on Industrial Informatics			
刊名	IEEE Transactions on Industrial Informatics		
年份	2021		
ISSN	1551-3203		
Review	否		
Open Access	否		
Web of Science	SCIE		
	学科	分区	Top期刊
大类	计算机科学	1	是
小类	AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS 自动化与控制系统	1	-
	COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机：跨学科应用	1	
	ENGINEERING, INDUSTRIAL 工程：工业	1	

IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS

审稿周期短，其他没了解																																							
<div>2022年 ▾</div> <div>IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS</div> <table><tr><td>刊名</td><td colspan="3">IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS</td></tr><tr><td>年份</td><td colspan="3">2022</td></tr><tr><td>ISSN</td><td colspan="3">1070-9908</td></tr><tr><td>Review</td><td colspan="3">否</td></tr><tr><td>Open Access</td><td colspan="3">否</td></tr><tr><td>Web of Science</td><td colspan="3">SCIE</td></tr><tr><td></td><td>学科</td><td>分区</td><td>Top期刊</td></tr><tr><td>大类</td><td>工程技术</td><td>2</td><td>否</td></tr><tr><td>小类</td><td>ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程：电子与电气</td><td>3</td><td>-</td></tr></table>				刊名	IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS			年份	2022			ISSN	1070-9908			Review	否			Open Access	否			Web of Science	SCIE				学科	分区	Top期刊	大类	工程技术	2	否	小类	ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程：电子与电气	3	-
刊名	IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS																																						
年份	2022																																						
ISSN	1070-9908																																						
Review	否																																						
Open Access	否																																						
Web of Science	SCIE																																						
	学科	分区	Top期刊																																				
大类	工程技术	2	否																																				
小类	ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程：电子与电气	3	-																																				

ICME | ICASSP

CCF-B
毕业神会，其他没了解

期刊会议相关

期刊层次查询网站

https://www.x-mol.com/8Paper/list
中国科学院文献情报中心期刊分区表 (fenqubiao.com)

文献来源

ICCV – ECCV – CVPR 图形学顶会 SIGGRAPH
精选了 61 篇三维点云顶会论文及源码分享, 含 2023 最新 - 知乎 (zhihu.com) Docs (feishu.cn)
(45 封私信 / 80 条消息) 有没有人可以一个人在家发表图形学顶会 (SIGGRAPH) 论文? - 知乎 (zhihu.com) Peng-Shuai Wang (wang-ps.github.io) 王鹏帅-AI2000-北大王选计算机实验室-三维深度学习

综述_Deep Learning for 3D Point Clouds: A Survey

【论文阅读·综述】Deep Learning for 3D Point Clouds: A Survey_deep learning for 3d point clouds: a survey 论文阅读-CSDN 博客

综述_Deep 3D Object Detection Networks Using LiDAR Data A
Review

综 述 _A Survey on 3D Object Detection Methods for
Autonomous Driving Applications

综述_[作为一个 0 基础三维点云深度学习的研究生，如何快速入门？ - 知乎 \(zhihu.com\)](#)